

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Takashi TAKAMURA

Serial No: 09/737,287

Filed: December 13, 2000

For: PACKAGE FOR SEMICONDUCTOR CHIP

ASSOCIATE POWER OF ATTORNEY
(37 C.F.R. § 1.34)

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

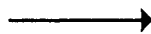
Dear Sir:

Please recognize the following as my associate attorneys in the above-entitled application:

STUART LUBITZ, Reg. No. 20,680; JOHN P. SCHERLACHER, Reg. No. 23,009; ALFRED A. D'ANDREA, JR., Reg. No. 27,752; WILLIAM J. KUBIDA, Reg. No. 29,664; MATTHEW BAILEY, Reg. No. 33,829; STUART T. LANGLEY, Reg. No. 33,940; CAROL W. BURTON, Reg. No. 35,465; STEVEN C. PETERSEN, Reg. No. 36,238; WILLIAM H. WRIGHT, Reg. No. 36,312; MICHAEL L. CRAPENHOFT, Reg. No. 37,115; DAVID LUBITZ, Reg. No. 38,229; WEI-NING YANG, Reg. No. 38,690; CELINE CROWSON, Reg. No. 40,357; STERLON R. MASON, Reg. No. 41,179; SARAH S. O'ROURKE, Reg. No. 41,226; LAWRENCE J. McCLURE, Reg. No. 44,228; WEI-FU HSU, Reg. No. 45,723; ERIN P. MADILL, Reg. No. 46,893; BRIAN D. MARTIN, Reg. No. 47,771; KENTON B. ABEL, Reg. No. 49,051.; DAVID BEN-MEIR, Reg. No. 46,152; YING CHEN, Reg. No. 50,193; ANTHONY J. ORLER, Reg. No. 41,232; PAUL B. HEYNSSSENS, Reg. No. 47,648; MINDA R. SCHECHTER, Reg. No. 38,296

Please associate this case with this firm's customer number:

☒ Customer Number **000026021**



26021

PATENT TRADEMARK OFFICE

Respectfully submitted,

HOGAN & HARTSON L.L.P.

By: 

John P. Scherlacher

Registration No. 23,009

Attorney for Applicant(s)

Date: May 8, 2002

500 South Grand Avenue, Suite 1900
Los Angeles, California 90071
Phone: 213-337-6700
Fax: 213-337-6701

Seiko Epson Ref. No.: F005309US00

Attorney's Ref. No.: 81754.0045

Declarati n and P wer of Attorm y F r Pat nt Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私書箱、国籍は、下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名称が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

半導体チップのパッケージPACKAGE FOR SEMICONDUCTOR CHIP

上記発明の明細書（下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付）は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☒ 2000 年 12 月 13 日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 国際出願番号を 09/737,287 とし、（該当する場合） _____ に訂正されました。☒ was filed on December 13, 2000 as United States Application Number or PCT International Application Number 09/737,287 and was amended on _____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japan s Language D clarati n (日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基づき下記の、米国以外の国の少なくとも1ヶ国を指定している特許協力条約365条(a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s)

外国での先行出願

Priority Not Claimed

優先権主張なし

<u>11-353067</u> (Number) (番号)	<u>Japan</u> (Country) (国名)	<u>13/December/1999</u> (Day/Month/Year Filed) (出願年月日)
<u> </u> (Number) (番号)	<u> </u> (Country) (国名)	<u> </u> (Day/Month/Year Filed) (出願年月日)

☐
☐

私は、第35編米国法典119条(e)項に基づいて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119 (e) of any United States provisional application(s) listed below.

<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)
--	---

私は下記の米国法典第35編120条に基づいて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365 (c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application:

<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)	<u> </u> (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、放棄済)
<u> </u> (Application No.) (出願番号)	<u> </u> (Filing Date) (出願日)	<u> </u> (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行なう表明が真実であり、かつ私が入手した情報と私の信じているところに基づく表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状： 私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人として、下記の者を指名いたします。(弁護士、または代理人の氏名及び登録番号を明記のこと)

Stuart Lubitz, (Reg. 20,680)
 Luis A. Mok, (Reg. 22,585)
 John P. Scherlacher, (Reg. 23,009)
 William H. Wright, (Reg. 36,312)
 David Lubitz, (Reg. 38,229)
 Wi-Ning Yang, (Reg. 38,690)
 Alfred A. D'Andrea, Jr., (Reg. 27,752)
 William J. Kubida, (Reg. 29,664)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

Stuart T. Langley, (Reg. 33,940)
 Michael Byorick, (Reg. 34,131)
 Carol W. Burton, (Reg. 35,465)
 Steven C. Peterson, (Reg. 36,238)
 Steven K. Barton, (Reg. 36,445)
 Sarah S. O'rourke, (Reg. 41,226)
 E. Matthew G. Dyor, (Reg. 42,278)

書類送付先:

HOGAN & HARTSON LLP.
 Biltmore Tower
 500 S. Grand Ave. Ste. 1900
 Los Angeles, CA 90071

Send Correspondence to:

HOGAN & HARTSON LLP.
 Biltmore Tower
 500 S. Grand Ave. Ste. 1900
 Los Angeles, CA 90071

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

HOGAN & HARTSON LLP.
 213-337-6700

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

HOGAN & HARTSON LLP.
 213-337-6700

唯一または第一発明者名

高村 孝士

Full name of sole or first inventor

Takashi TAKAMURA

発明者の署名

高村 孝士

日付

2001年4月4日

Inventor's signature

Takashi Takamura

Date

Apr. 4, 2001

住所

日本国

長野県

茅野市

Residence

Chino-shi, Nagano-ken, Japan

国籍

日本

Citizenship

Japan

私書箱

392-8502 日本国長野県諏訪市大和3丁目3番5号
 セイコーエプソン株式会社内

Post Office Address

c/o Seiko Epson Corporation
 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

第二共同発明者

Full name of second joint inventor, if any

第二共同発明者の署名

日付

Second inventor's signature

Date

住所

日本国

Residence

Japan

国籍

Citizenship

私書箱

Post Office Address

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をすること)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)